

各位

会社名 株式会社 安永
代表者名 代表取締役社長 安永 暁俊
(コード：7271、東証スタンダード)

新製品(ウィック)のスマートフォン向け受注と量産開始のお知らせ

この度、株式会社安永(代表取締役社長:安永暁俊、以下「当社」)の新製品であるウィックが、スマートフォン向けに受注を受け、本年度より量産開始したことをお知らせいたします。

1. 背景

ウィックは、電子機器向け放熱部品として広く使用される「ベイパーチャンバー」の基幹部品として用いられる部品で、当社が新事業の創出を目指し独自開発した微細形状加工技術を用いた加工箔に株式会社村田製作所(本社:京都府長岡京市、代表取締役社長:中島 規巨)の設計ノウハウを組み合わせた共同開発品として2023年5月に商品化されました。これまで一部の小型電子部品やノートパソコンの放熱部品向け量産受注を経て評価をいただき、本製品のボリュームゾーンであるスマートフォン市場での採用に至りました。

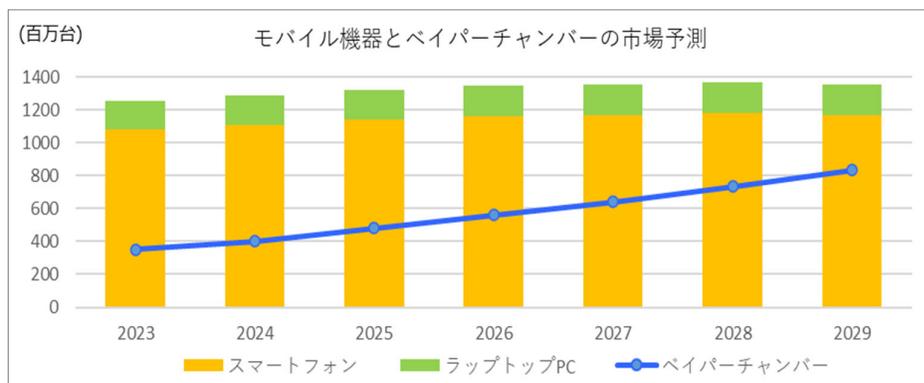
2. ウィックの概要とニーズの拡大について

昨今の電子機器の高性能・大容量・高速通信化によるデータ処理量の著しい増加にともない、デバイスの熱対策が必要不可欠となっております。特にスマートフォンは高機能・大型・薄型化が進んでおり、従来のウィックでは薄型化と放熱性能の両面で市場ニーズへの対応が困難となってきています。

当社の微細形状加工技術を用いたウィックは、競合製品と比較し薄型でありながらも数倍の毛細管力を有し、薄型化と放熱性能を両立できる点が強みです。本製品を用いたベイパーチャンバーは、超薄型構造でありながら、スマートフォンに求められる入熱量に対しても高い均熱特性を達成することができ、ノートPC向けではGPU(※)の発熱に対応できる性能を有していることから、市場で大きな注目を集めております。

図1:モバイル機器とウィックの市場成長予測

スマートフォン、ラップトップPCは数量の伸びは無いが、薄型高機能化が進む為ベイパーチャンバー市場は拡大する。



・採用が期待される主な用途

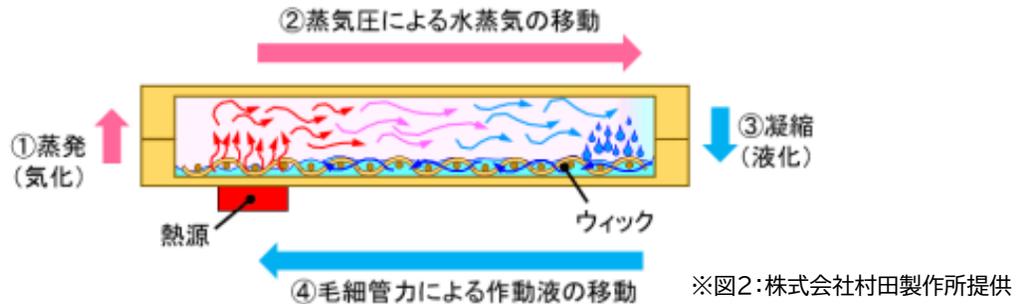


DATA)富士カメラ総研と Report Prime の市場予測をベースにて弊社にて編集

今後も超薄型・高性能ウィックのニーズは拡大すると予測し、安定品質での量産対応を行いながら増産体制を構築し、次年度以降のさらなる受注量拡大に備えてまいります。

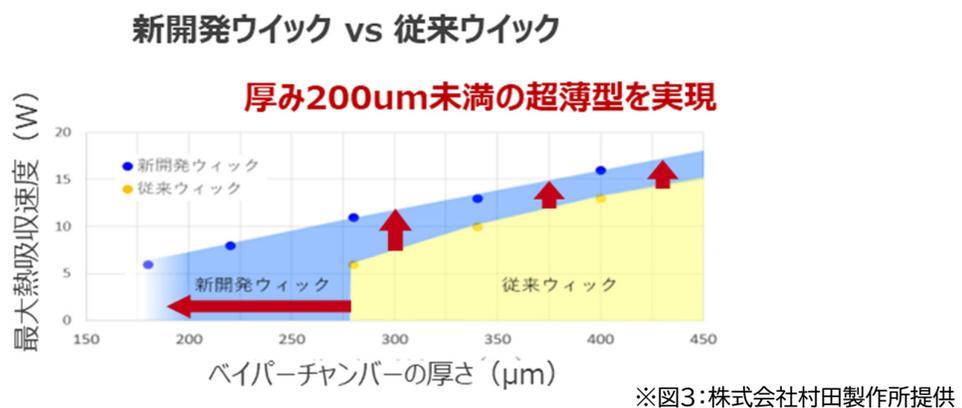
※GPU・・・GPUとは「Graphics Processing Unit」の略で、3Dグラフィックスなどの画像描写を行う際に必要となる計算処理を行う半導体チップ(プロセッサ)のこと。

図2:バイパーチャンバーの構造とウィックについて



熱源で生じた熱を受けて作動液が蒸発し、蒸気がバイパーチャンバー内部で拡散することで放熱を行う。

図3:当社の微細加工技術を用いた新開発ウィックの性能



3. 新事業の今後について

当社の微細形状加工技術を用いて製品化された事業は、リチウムイオン電池向け電極活性化装置に次いで2つ目となります。これら両方の新事業を安定的に拡大する事で、不確定な世界情勢の中で安定的に収益を上げられる体制を構築してまいります。また、今後の情報化社会において、電子機器の熱マネジメントに欠かせない本製品を拡大させて、人々の生活の豊かさに貢献してまいります。

尚、最終製品の使用先及び販売額等は秘密保持契約により開示できませんので、ご理解のほどお願い致します。

4. お問い合わせ先

経営企画部：蔵本、稲森
TEL：0595-24-2122

以 上